

# 연수 제안서

연구 분야	스핀 소자를 이용한 차세대 컴퓨팅 및 센서
연구 과제명	랜덤 스핀 소자를 이용한 확률론적 컴퓨팅
연수 제안 업무	차세대 반도체 소자 공정 및 특성 분석
<div>(연수 내용)</div> <div>- 연수기간 : 2023.5.01.~2024.01.31</div> <div>- 연수 내용 :</div> <div>1. 반도체 공정 장비를 활용한 차세대 반도체 소자 공정 및 특성 측정</div>	
<div>소속 부 서 : 스핀융합연구단</div> <div>연수 책임자 : 이억재</div>	